

Transfer Molding System

Model YPM1180



All-in-one transfer molding system for high quality molding

用于高质量成形的多合一注塑成形设备

产品信息



中文

- 可对应100×300mm尺寸的框架
- 采用本公司独创的高刚性压机结构(Hold frame)，实现了均匀的合模压力和最佳的产品动线，以及紧凑的占地面积
- 可搭载分离膜装置(在侧面注胶规格的情况下)
- Side gate/Top gate均可对应
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



SPECIFICATION

Items			Unit	Description			
机型			—	YPM1180			
框架・基板类型			—	基板・引线框架			
框架・基板尺寸	长度		mm	150—300			
	宽度		mm	35—100			
树脂	径		mm	φ 13, 14, 16, 18, 20			
	长度		mm	14.3—35.0			
机械时间			sec	Approximately 20 (25*)			
外形尺寸	模组数量		module	1	2	3	4
	堆叠式收料方式	宽度	mm	2,540	3,220	3,900	4,580
		纵深	mm	1,600 (1,635*)	1,600 (1,635*)	1,600 (1,635*)	1,600 (1,635*)
		高度	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
	插片式收料方式	宽度	mm	2,540	3,220	3,900	4,580
		纵深	mm	2,000	2,000	2,000	2,000
		高度	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
	重量	堆叠式收料方式		ton	6.3 (6.4*)	10.0 (10.2*)	13.7 (14.0*)
插片式收料方式		ton	6.6 (6.7*)	10.3 (10.5*)	14.0 (14.3*)	17.7 (18.1*)	
每模成形框架数量			workpiece	2	4	6	8
进料盒空间			mm	440			
出料盒数量 (堆叠式收料方式)			pcs	2			
出料盒空间 (插片式收料方式)			mm	440			
合模压力			kN／(tf)	294.0—1,764.0／30.0—180.0			
注塑压力			kN／(tf)	3.92—49.0／0.4—5.0 (2 step pressure setting)			
品种切换方式			—	采用KIT更换方式			
可以安装的模具			—	L, XL, 1.5XL, XXL			
使用分离膜的宽度			mm	100—300*			

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要可能有改良变更的可能
- 如有其他特殊规格要求，另行协商
- *的值是用于分离膜规格



东和半导体设备（上海）有限公司
中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters

TOWA Corporation

China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
TOWA Taiwan Co., Ltd.

Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

Malaysia

TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

Philippines

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

Germany

TOWA Europe GmbH

Netherlands

TOWA Europe B.V.

the United States

TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ